



IMPACT REPORT

2021年第七届中国硬件创新创客大赛

影响力报告

Influence Report of the 7th China Hardware Innovation and Maker Competition in 2021

中国硬件创新创客大赛组委会

CONTENTS

目录

01

2021年
大赛总结

02

硬创大赛
总体介绍

03

2022年
大赛规划

04

华秋介绍
联系我们



01

2021年大赛总结

2021年第七届中国硬件创新创业大赛概况

第七届中国硬件创新创业大赛（以下简称“大赛”）是由深圳市福田区科技创新局、深圳市福田区企业发展服务中心指导，深圳华秋电子有限公司主办。

大赛自启动以来，共吸引600+来自硬科技领域的创业项目，参赛队伍地域覆盖华南、华北、华东三大地区，其中华南赛区作为深创赛福田区预选赛赛道，2021年共计推荐晋级深创赛半决赛项目11个，在深创赛行业决赛中获得2个优秀奖，4个项目成功晋级国赛。大赛今年还增设了集成电路赛道。项目涵盖芯片、5G、人工智能、物联网、机器视觉、智能终端等多个领域。

经过层层筛选，由3大赛区+1个赛道产生的十三强项目方进入2021年12月17日全国总决赛，最终产生全国前三强获奖项目；大赛同期还举办了“硬科技产业投融资论坛”，希望本次论坛成为一个新的契机，以及链接企业家与投资人，构筑硬件生态共同体。

COMPETITION SCHEDULE

2021年大赛赛程

- ▶ 线上主题分享：技术开发培训、供应链知识培训、创业心得分享、资本经验分享、赛前实践培训
- ▶ 线下路演集训营：投融资对接、路演技巧、行业剖析

赛前培训

2021年4月-8月

上海市浦东新区
创智空间康桥创新广场多功能厅

华东分赛区

2021年9月24日

2021年8月21日

华南分赛区

深圳市福田区
阿里云创新中心路演厅

2021年10月21日

华北分赛区

线上实时路演直播

深圳市福田区
新一代产业园1-2栋M层

全国总决赛

2021年12月17日

2021年大赛活动数据

大赛宣传曝光量

850000+

报名项目数量

600+

合作投资机构

100+

产业生态合作伙伴

150+



线下活动
参会人数

报名人数

2000+

实际签到人数

800+



线上直播
参会人数

报名人数

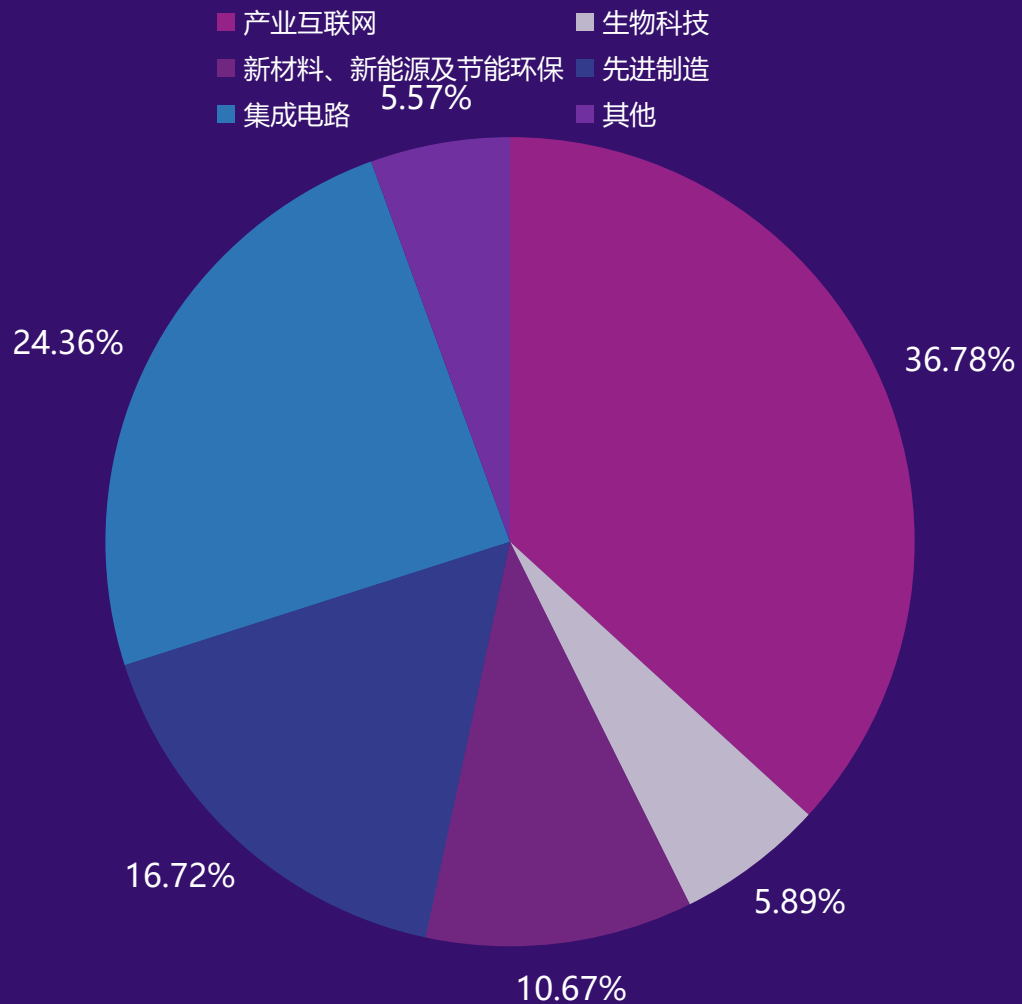
3000+

实际签到人数

4500+

THE REGISTRATION NUMBER

2021年硬创项目数据分析



项目行业分类



项目报名数量总计：600+

分为六大类：集成电路/153个；产业互联网/231个；生物科技/37个；先进制造/105个；新材料、新能源及节能环保/67个；其他类/35个

按项目轮次



70%项目为早期初创企业，融资大多在天使轮/种子轮/pre-A；20%为A轮以上项目，剩余10%为团队项目。

参赛需求



大多早期项目寻求资金和行业内部合作，部分参赛为提高知名度，推荐深创赛。

HARD TO CREATE THE FINAL PROJECT

2021年晋级硬创总决赛十三强项目

序号	项目名称	企业名称	最新融资轮次	最新融资时间	投资方
1	业界最小封装高频QR氮化镓控制器-MK2697G	茂睿芯（深圳）科技有限公司	C轮	2021/10/29	惠友投资、领汇投资、鹏晨投资
2	无屏触控智能机器人	北京物灵科技有限公司	B轮	2019/03/01	君信资本
3	黄鹂智声智能通话降噪耳机	深圳黄鹂智能科技有限公司	暂未披露		
4	氮化镓功率器件与驱动芯片	晶通半导体（深圳）有限公司	天使轮	2021/12/02	永创伟业
5	智能半导体气体传感器	艾感科技（广东）有限公司	暂未披露		
6	MEMS高精度惯导模组和工业级惯性芯片	杭州麦新敏微科技有限责任公司	暂未披露		
7	汽车4D毫米波雷达	上海蛮酷科技有限公司	Pre-A轮	2021/5/24	将门创投、盐城国智、生益资本、招商启航
8	半导体全自动检测	东莞速测检测设备有限公司	暂未披露		
9	PINPOINT手术机器人	深圳市箴石医疗设备有限公司	天使轮	2020/5	HAX
10	全球领先的TFT芯片供应商	杭州领擎科技有限公司	Pre-A轮	2021/08/25	真格基金、十维资本
11	高纯镓及三代半材料产业化项目	华夏半导体（深圳）有限公司	暂未披露		
12	军用级无人安防解决方案	智慧起源机器人（苏州）有限公司	天使轮	2020/10/16	苏高新创投集团
13	开源鸿蒙手表OS发行版	好叭科技（上海）有限公司	种子轮		

2021年硬创总决赛前三甲项目信息



周 银 | 茂睿芯 TECHNICAL MARKETING

业界最小封装高频QR氮化镓控制器—MK2697G

MK2697G是一颗直驱E-GAN的高频QR PWM控制芯片。MK2697G，其很宽的VCC工作电压范围(9V-90V)可以使其覆盖PD/PPS从3.3V-23V的输出范围而不需要使用额外的绕组或者线性降压电路。集成了E-GAN的驱动技术，简化驱动电路设计，同时优化了驱动设计，可以有效降低原副边功率管的电压应力。精准的产品定义，采用SOT23-6的小封装，就实现了高频高效的功能设计。



顾嘉唯 | 物灵科技 CEO

无屏触控智能机器人

于2016年率先开创了“无屏触控智能机器人技术”，旨在帮助孩子从屏幕回归到纸质书阅读，连接多学科的AI陪练，重构既有“育”家庭学习方式，提升在线教育的学习效率、专注力和自驱力。



刘 志 | 黄鹂智声 CEO

黄鹂智声智能通话降噪耳机

语音通信和交互市场容量超万亿，增长趋势显著。本项目由技术、产品和销售的杰出人才组成互补团队，以拾音灭噪技术和产品切入，解决行业痛点问题，壁垒及天花板高，稀缺性强。项目技术水平国际领先，荣获多项国家级和省部级奖项；通过清晰的商业策略和模式，一年内就拿下多个行业龙头订单，主营收入超千万并已实现盈利。

THE CONTEST'S OFFICIAL WEBSITE

2021年大赛官网

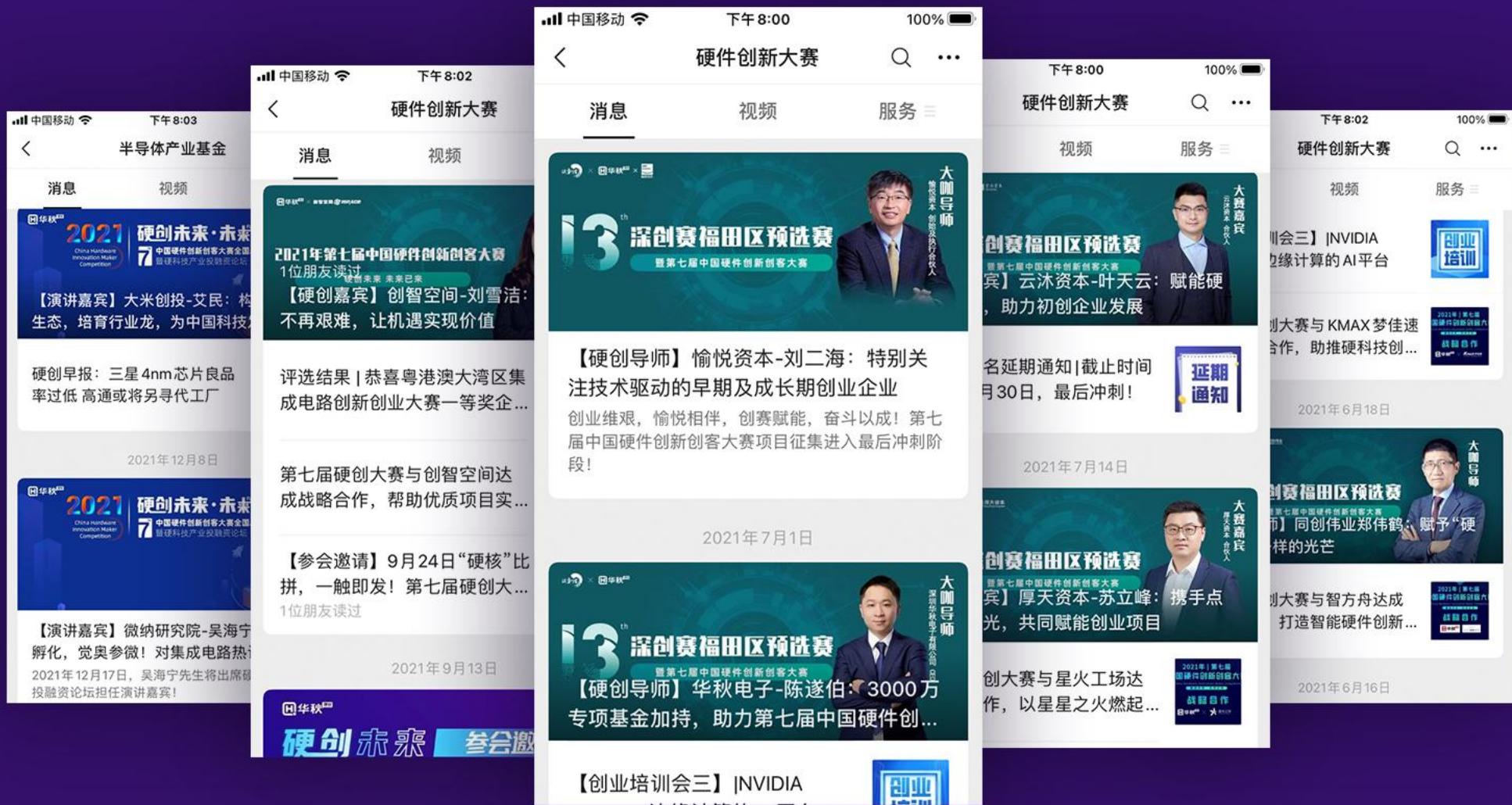


(电脑端)



(移动端)

赛前：“硬创导师”系列宣传



THE PUBLICITY

赛前：导师+项目视频宣传



赛后媒体报道



REPORTS

赛后：项目专篇报道

硬创资讯 | 第七届硬创赛冠军茂睿芯科技：以国际大厂 SOP-9 功能

硬件创新大赛 2022-01-06 18:00

2021年12月17日，由深圳华秋电子有限公司主办的第七届中国硬件创新创业大赛全国总决赛在福田区新一代产业园隆重举办。本届大赛参赛队伍地域覆盖华南、华北、华东三大地区，还增设了电路赛道。项目涵盖芯片、5G、人工智能、物联网、机器视觉、智能终端等多个领域。层层筛选，诞生了13强项目方进入全国总决赛。

活动当日，在现场激烈角逐下诞生了第七届硬件创新创业大赛总决赛冠军——**业界最小封装高频QR氮化镓控制器—MK2697G**，



在本届硬件创新创业大赛路演环节中，茂睿芯团队展示的项目是：**业界最小封装高频QR氮化镓控制器—MK2697G**。

硬创资讯 | 第七届硬创赛季军黄鹂智能科技：让世界

硬件创新大赛 2022-01-13 18:00

2021年12月17日，由深圳华秋电子有限公司主办的第七届中国硬件创新创业大赛全国总决赛在福田区新一代产业园隆重举办。本届大赛参赛队伍地域覆盖华南、华北、华东三大地区，还增设了电路赛道。项目涵盖芯片、5G、人工智能、物联网、机器视觉、智能终端等多个领域。层层筛选，诞生了13强项目方进入全国总决赛。

活动当日，在现场激烈角逐下诞生了第七届硬件创新创业大赛总决赛季军——**黄鹂智声智能通话降噪耳机**，过关斩将



在本届硬件创新创业大赛路演环节中，黄鹂智能团队展示的项目是：**黄鹂智声**

硬创资讯 | 第七届硬创赛13强晶通半导体：氮化绿色智能未来！

半导体产业基金 2022-01-19 08:00

2021年12月17日，由深圳华秋电子有限公司主办的第七届中国硬件创新创业大赛全国总决赛在福田区新一代产业园隆重举办。本届大赛参赛队伍地域覆盖华南、华北、华东三大地区，还增设了电路赛道。项目涵盖芯片、5G、人工智能、物联网、机器视觉、智能终端等多个领域。层层筛选，诞生了13强项目方进入全国总决赛。

活动当日，华南赛区冠军项目暨全国13强选手晶通半导体（深圳）有限公司，展示了其**氮化硅功率器件**项目亮点十足，获得了广泛关注。



在本届硬件创新创业大赛路演环节中，晶通半导体团队展示的项目是：**氮**

硬创资讯 | 第七届硬创赛13强蛮酷科技：以毫米波雷达切入提供全面自动驾驶解决方案

半导体产业基金 2022-01-18 18:27

2021年12月17日，由深圳华秋电子有限公司主办的第七届中国硬件创新创业大赛全国总决赛在福田区新一代产业园隆重举办。本届大赛参赛队伍地域覆盖华南、华北、华东三大地区，还增设了电路赛道。项目涵盖芯片、5G、人工智能、物联网、机器视觉、智能终端等多个领域。层层筛选，诞生了13强项目方进入全国总决赛。

活动当日，全国13强选手上海蛮酷科技有限公司旗下的**自动驾驶4D成像毫米波雷达**项目获得了广泛关注。



在本届硬件创新创业大赛路演环节中，蛮酷科技团队展示的项目是：**自动驾驶4D成像毫米波雷达**

GUESTS INTERVIEW

论坛：嘉宾演讲回顾

微纳研究院—吴海宁：陷阱与思考

半导体产业基金 2022-01-06 08:00



【吴海宁先生演讲】

2021年12月17日，由深圳华秋电子有限公司主办的“第七届中国硬件创新创业大赛全国总决赛暨硬科技产业投融资论坛”在深圳圆满收官。本次论坛围绕硬科技领域的投融资话题展开，旨在链接投资人，共同研讨产业及创投的聚合，构筑更为开放、协同的硬科技生态共同体。

活动当日，微纳研究院CTO吴海宁先生发表了主题演讲。

启赋资本—宋昶：产业数字化帮助企业

半导体产业基金 2022-01-04 08:00



【宋昶先生演讲】

2021年12月17日，由深圳华秋电子有限公司主办的“第七届中国硬件创新创业大赛全国总决赛暨硬科技产业投融资论坛”在深圳圆满收官。本次论坛围绕硬科技领域的投融资话题展开，旨在链接投资人，共同研讨产业及创投的聚合，构筑更为开放、协同的硬科技生态共同体。

活动当日，启赋资本TMT行业合伙人宋昶先生发表了主题演讲。

大米创投—艾民：生态圈催生丰富项目

半导体产业基金 2022-01-05 08:00

2021年12月17日，由深圳华秋电子有限公司主办的“第七届中国硬件创新创业大赛全国总决赛暨硬科技产业投融资论坛”在深圳圆满收官。本次论坛围绕硬科技领域的投融资话题展开，旨在链接投资人，共同研讨产业及创投的聚合，构筑更为开放、协同的硬科技生态共同体。

活动当日，大米创投创始人艾民先生发表了主题为《硬科技产业投融资》的演讲。



大米创投创始人艾民

以下是艾民先生在【硬科技产业投融资】

愉悦资本—刘二海：硬科技加商业创新，加速构建伟大企业

半导体产业基金 2021-12-31 08:00

2021年12月17日，由深圳华秋电子有限公司主办的“第七届中国硬件创新创业大赛全国总决赛暨硬科技产业投融资论坛”在深圳圆满收官。本次论坛围绕硬科技领域的投融资话题展开，旨在链接投资人，共同研讨产业及创投的聚合，构筑更为开放、协同的硬科技生态共同体。

活动当日，愉悦资本创始及执行合伙人刘二海先生发表了主题为《硬科技与商业模式创新》的演讲。



愉悦资本创始及执行合伙人刘二海先生

COMPETITION JUDGES

2021年大赛评委



艾民

大米创投
创始人



舒清

同创伟业
董事总经理



王宇博

愉悦资本
投资总监



陈苏里

启赋资本
新材料行业合伙人



叶天云

云沐资本
合伙人



陈冠潼

顺为资本
分析师



刘旭

旦恩资本
合伙人



郭剑武

星视界资本
创始人



吴海宁

微纳研究院
CTO



王海全

正轩投资
创始合伙人



易军

中城康帕斯科技智能终端
总经理



刘辉

红杉资本
高级顾问



张天宇

云沐资本
副总裁



赵琮

深圳中电智方舟运营有限公司
董事长兼总经理



彭数学

旭源资本
创始人



武起予

HAX硬件加速器
中国项目总监



张林安

金地（集团）股份有限公司
高级股权投资专业经理



钟寅生

佳兆业科技集团
投资总监



王科力

君海创芯
投资总监



苏立峰

厚天资本
合伙人



于红梅

九核资本
管理合伙人



杜波

星河资本
董事总经理



陈剑青

临芯投资
投资总监



王常青

晨晖创投
投资总监



杨晓杰

厚天资本
总经理



董春晖

车库咖啡产业创新投资中心
总经理



步日欣

创道投资咨询
合伙人

2021年12月17日硬创总决赛同期还举办了**硬科技产业投融资论坛**，邀请了众多行业嘉宾，前来分享投资经验和预见投资风向



刘二海

愉悦资本 创始及执行合伙人

“硬科技的方向非常多，比如AI、生物技术、IoT、机器人、半导体、新材料等等。硬科技有几个特点，首先，技术的发展是无止境的，有无尽的前沿；其次，技术发展有必经阶段，分为技术出现、体系架构与核心组件、典型应用、基础设施化、经济重构这五个阶段。我们创业，必须尊重客观规律，如果刚刚出现的技术就投入到行业里，基本上你需要漫长的等待期，如果切入得太晚，别人已经在搞，你就没有什么创新度了。所以“架构与组建”、“典型应用”这些阶段都是非常适宜的硬科技创业切入时点。如果到了基础设施化阶段，那就已经到了另外的具体产业里，比如咖啡或者生命科学，做硬科技的人在具体产业里并不具备优势。这是非常重要的阶段问题。”

—摘自刘二海先生于硬创总决赛分享主题《硬科技与商业模式创新》部分内容



宋昶 启赋资本 TMT行业合伙人
演讲主题：数字化浪潮下的硬科技投资



艾民 大米创投 创始人
演讲主题：硬科技生态圈投资理念与实践分享



吴海宁 微纳研究院 CTO
演讲主题：热话题的冷思考



于世璿 厚天资本合伙人
演讲主题：小米耳机开启中国产品生态链的序幕

2021年总决赛活动回顾





02

硬创大赛整体介绍

中国硬件创新创客大赛介绍

<中国硬件创新创客大赛>是由深圳市福田区科技创新局指导，深圳华秋电子有限公司主办，面向硬科技初创企业及团队的专业赛事。

大赛自2015年举办以来，影响了超过45万工程师群体，吸引了35000多名硬创先锋报名参加线上线下培训会，并成功聚集了400多家生态合作伙伴，与近500家顶级资本方建立合作。截止到目前，大赛已累计服务超过4000个项目。随着影响力的扩大，<中国硬件创新创客大赛>已成为中国硬件创新领域重要赛事之一。



往届参赛项目（部分）：他们出自中国硬件创新大赛 估值超100 亿

序号	项目名称	企业名称	最新融资轮次	最新融资时间	投资方
1	高性能5G射频前端芯片和模组	锐石创芯(深圳)科技有限公司	D轮	2021/7/26	临芯投资、粤财创投、粤财基金、江北嘴投资、浩轩投资
2	MCU	深圳市航顺芯片技术研发有限公司	C轮	2021/6/25	顺为资本
3	计算机视觉PaaS云平台	深圳极视角科技有限公司	C轮	2021/9/14	经控金融投资集团、兰馨亚洲、青岛国信、高通创投
4	物联网操作系统	RT-Thread	B轮	2019/11/26	GGV纪源资本、君联资本
5	智能魔镜	深圳市锐吉电子科技有限公司	A轮	2018/12/27	云启资本
6	大数据芯片及方案	北京忆芯科技有限公司	B轮	2021/9/17	启迪新基建、正奇投资、中电拓方、中海创投、协立投资、金控集团、民航股权投资基金
7	MR BOX	深圳游视虚拟现实技术有限公司	A轮	2016/9/1	武汉华博通讯有限公司、中国宝安
8	AR智能眼镜	北京悉见科技有限公司	A轮	2018/8/20	联想之星、金科君创、谷银基金、联想控股、雷鸣(前小米公司高管、亚马逊公司高管)
9	人工智能芯片及AI开发平台	深圳鲲云信息科技有限公司	B轮	2021/6/16	清源投资、北京中翔运达
10	可交互空中成像技术	安徽省东超科技有限公司	A+轮	2021/10/26	伟时电子
11	WiFi 2.0解决方案	深圳鲲鹏无限科技有限公司	B轮	2021/7/23	铭普光磁
12	机器人底盘	北京布科思科技有限公司	A轮	2018/11/27	泰达科投
13	柔性机械爪	慧灵科技(深圳)有限公司	战略投资	2021/6/25	万物资本
14	工业智能机器人	北京若贝特智能机器人科技有限公司	A+轮	2021/2/4	珠海高新投、清合投资
15	AI工业视觉	深圳市心鉴智控科技有限公司	A轮	2021/3/12	经纬创投、华映资本、松禾资本、奇绩创坛
16	人工智能ETC	深圳市安煌信息技术有限公司	A轮	2017/7/21	投控东海、深圳市财纳易资本管理有限公司
17	无人驾驶系统	武汉环宇智行科技有限公司	A轮	2021/5/20	芯原股份、华策教投基金
18	5G基站射频收发芯片	北京力通通信有限公司	A轮	2021/3/26	正业资本、潇湘资本、和利资本、宜通世纪、正业宏源
19	毫米波雷达应用	深圳电目科技有限公司	Pre-A轮	2021/7/29	美的资本
20	AR光学模组	深圳惠牛科技有限公司	A轮	2021/6/29	未公开

往届硬创大赛参赛项目（部分）



INVESTMENT PARTNRE 资本合作伙伴

中国硬件创新创客大赛长期为优质创业项目提供资本对接和融资服务，并和知名机构达成长期合作关系如：顺为资本、高瓴创投、愉悦资本、同创伟业、啟赋资本、深圳天使母基金、华登国际、华秋盘缠、IDG、HAX、中芯聚源、苏泊尔产业资本、创业接力、新视界资本、兴橙资本、洪泰基金、华创深大、点亮资本、君联资本、华颖资本、蓝驰资本、临芯投资、绿石创投、明照资本、北极光创投、青橙资本、赛马资本、海明资本、松禾资本、星火创投、耀途资本、英诺天使基金、招商局资本、正轩投资、合创资本、大米创投、旦恩资本、晨晖资本、达晨创投、厚天资本、福田产投、方信资本等**500+**家投资机构。



COOPERATION AGENCY 战略合作伙伴

战略合作伙伴/STRATEGIC PARTNERS



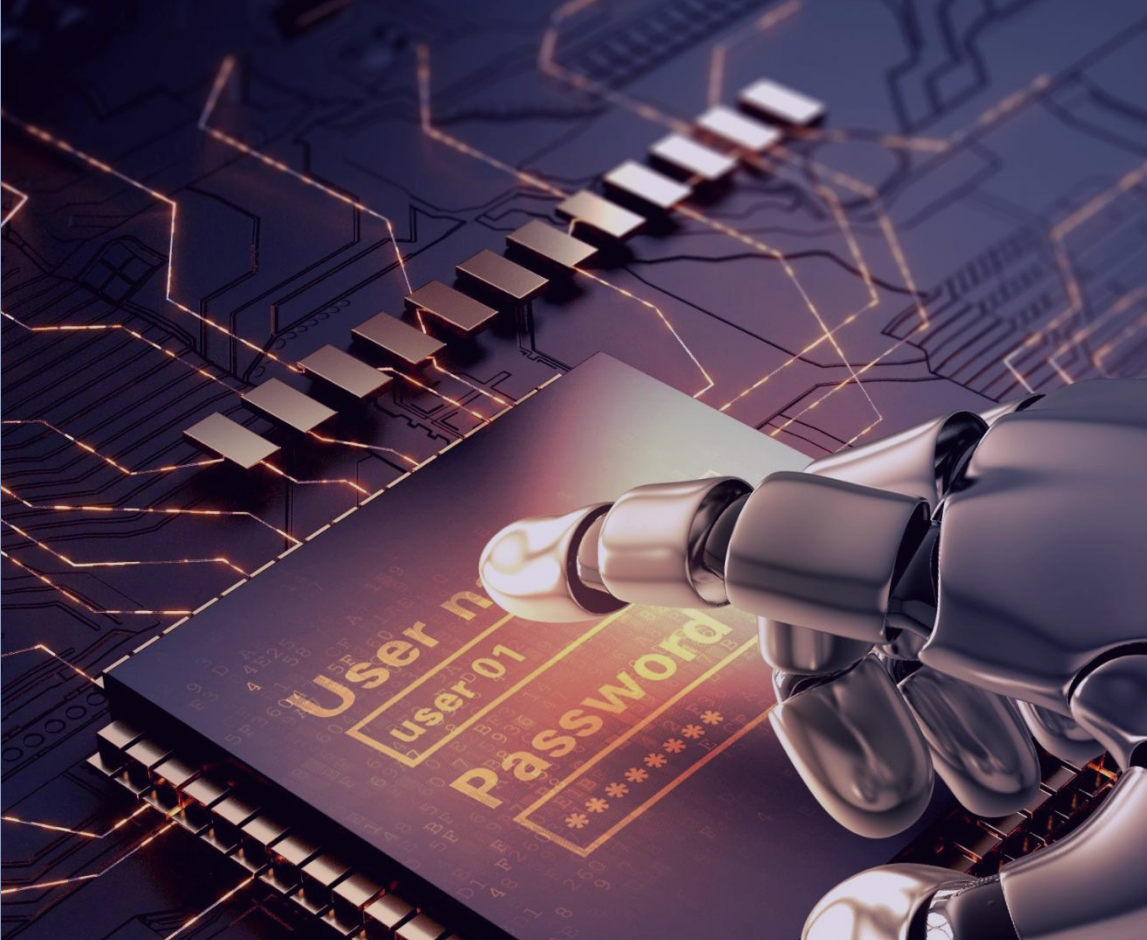
合作投资机构/INVESTMENT INSTITUTIONS





03

2022年大赛规划



2022年大赛规划（拟）

6大分赛区（华南/华东/华北/华中/西南/海外）

4条赛道（开源创新赛道/RISC-V赛道/PKS赛道/集成电路赛道）

1场训练营（为晋级总决赛项目提供创业、技术、投融资的系统赛前培训）

1场总决赛（总决赛+颁奖典礼）

华中/西南分赛区

扩大赛事覆盖范围，延伸华中及西南分赛区，挖掘更多内陆创新项目

海外分赛区

扩大赛事覆盖范围，延伸海外分赛区，挖掘更多海外创新项目

开源创新赛道

基于开源基金会下属开源项目生态的硬件创新赛道，挖掘全场景物联网创新项目。

RISC-V赛道

基于RISC-V生态创新赛道，完善RISC-V的芯片产业生态，并加速RISC-V的产业化应用。

PKS赛道

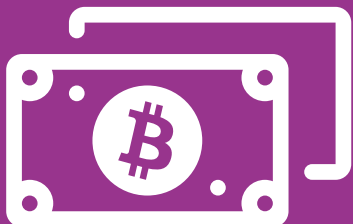
聚焦信创产业基础软硬件及行业应用领域方向的赛道

>> 其它赛道洽谈中

2022年大赛服务

赛前/赛中服务

赛前/赛中：通过线下+线上举办政策研读、需求对接、企业辅导、人才沙龙、创投对接、政企座谈等，为参赛选手提供全方位资源扶持。



赛后服务

赛后：后续将通过空间、资金、团队等市场创新要素资源的对接，帮助创业者解决在深圳等地落地创业“最后一公里”的问题。



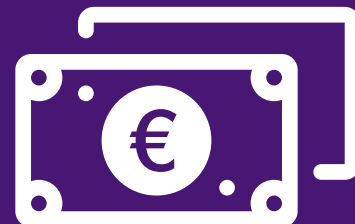
华秋支持

①专项基金5000万直投项目
②共生·供应链开通项目专项福利包（含商城、供应链大礼包）③三大赛事服务包，入孵服务、融资服务、采购服务



其他支持

①深圳落地服务
②合作孵化器入孵服务
③一线资本投资联合机会
.....





04

华秋介绍

深圳华秋电子有限公司介绍

华秋电子是一家致力于以信息化技术改善传统电子产业链服务模式的产业数智化服务平台。

自2011年成立以来,布局了百万工 程师社区平台“电子发烧友网”、卓越物联网方案设计能力的“华秋方案”、可制造性分析软件“华秋DFM”、高可靠多层板制造平台“华秋电路”、电子元器件电商“华秋商城”、PCBA制造平台“华秋智造”等服务平台。

全面打通产业上、中、下游,形成电子产业链闭 环生态,给行业带来“高品质,短交期,高性价比”的一站式服务平台,为中国电子信息产业创新与发展提供助力。



华秋电子--电子产业一站式服务平台

获得“头部”产业风投机构的战略投资

GL Ventures
高瓴创投



愉悦资本

順為
SHUNWEI



同创伟业
COWIN CAPITAL



啟賦資本
QF Capital



招商銀行
CHINA MERCHANTS BANK

- 2021年3月 华秋电子 完成 数亿元 C 轮融资
- 2021年7月 华秋电子 完成 3 亿元 C+ 轮融资

敬请期待

2022年第八届中国硬件创新创客大赛

大赛联系人：

刘女士：185 2083 8366

徐女士：159 7296 4176

黄先生：181 4581 3502

大赛邮箱：

hicc@elefancs.com